

证券代码：688456

证券简称：有研粉材

有研粉末新材料股份有限公司

投资者关系活动记录表（2024年12月6日）

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	泉果基金、银河基金、富安达基金、招银理财、长江证券、东兴证券、东北证券、国信证券、民生证券、杭州振源、国投证券、国泰君安、博时基金、华宝证券
会议时间	2024年12月6日9:30-10:30
会议地点	证券日报上海路演中心
上市公司接待人员	董事会秘书、财务总监、总法律顾问：姜珊 证券事务代表：王妍
投资者关系活动主要内容介绍	Q1：公司基本情况介绍。 A1：有研粉材成立于2004年，控股股东中国有研科技集团是国务院国资委所属中央一级企业，有研粉材属于二级中央企业。公司业务分为四个板块。第一个板块是铜基金属粉体材料，目前在国内市场占有率约35%，产销量国内第一、全球第二，主要应用于粉末冶金、金刚石工具、摩擦材料、催化剂、电碳电刷、散热器件等下游领域，该板块的公司有有研合肥、有研重冶和境外的有研泰国、英国Makin公司；第二个板块是微电子锡基焊粉材料，目前在国内市场占有率约15%，国内第一，主要应用于微电子的封装/组装，下游领域主要为消费电子，该板块公司有康

普锡威及其山东子公司；第三个板块是电子浆料，与微电子锡基焊粉材料都属于微电子互连材料，是公司重点发展的新板块，公司于2023年成立有研纳微发展该板块，锡膏是主打产品，目前市占率和销量都不是特别大，但是增速很快。第四个板块是增材制造用粉体材料（3D打印用粉体材料）板块，运营的公司为有研增材，于2021年底成立，3D打印粉体主要是比较有特色的铝合金粉、高温合金粉、铜合金粉和不锈钢粉，另外有研增材除了3D打印用粉体材料还生产一些高温特种粉体材料如软磁、MIM粉等。公司前三季度整体销量23,000吨，同比增长10%，营业收入23亿元，同比增长18%，其中销量增长带来的增量是11%，由于原材料价格上涨带来的增量是7%。利润总额4,489万元，同比增长3%。

Q2：3D打印板块的产品结构是怎样的？今年整体放量的一个节奏是什么情况？

A2：3D打印板块产品基本构成是40%铝合金粉，包括铝硅十镁、铝硅七镁；20%高温合金粉；40%其他粉末，包括钛合金粉、铜合金粉、不锈钢粉等。前三季度销量比去年同期翻了一倍，全年还会有一个比较大的提升。

Q3：3D打印粉体材料在今年有比较明显的加速，整体加速的原因是什么？

A3：加速主要基于应用端的放量，该行业现在依然处于行业爆发的前期，但是公司明显感觉到需求端已经开始起量，公司产能开始受限，计划明年扩产。

Q4：公司3D打印粉体主要放量的是哪些领域？

A4：主要在航空航天领域，另外公司在汽车零部件、民用

手板等领域也在拓展。

Q5: 铜粉今年开拓了新的应用方向, 散热铜粉这块市场未来会有怎样的结果, 现在如何?

A5: 新型散热铜粉公司目前是独家生产, 主要对应的终端用户是行业的巨头。该产品是双方合作研发两年研制成功的, 公司现已实现稳定的吨级供货。据了解该产品除GPU, 目前已经部分应用于AI算力服务器、基站、大型路由器、交换机等场景, 应用效果截至目前反馈良好。今后供应体量还要依赖于下游的应用。

Q6: 公司在光伏领域铜粉方面有储备, 现在也在往浆料上拓展, 是否对市场有考察, 明确公司的定位是直接去做铜浆还是以铜粉去尝试切入这个领域?

A6: 公司从制备工艺上面是要从纳米铜粉去切入的。铜浆替代的可能是高温银浆, 但是高温对铜的抗氧化性能要求非常高, 所以目前还处于研发实验阶段。公司比较擅长铜基粉体的制备, 纳米级粉体制备工艺也已经纳入到公司承担的未来产业项目中。所以公司一直都在做纳米镍粉、铜粉、银粉的研发。另外, 对现在替代来讲, 其实银包铜是更容易替代银的一个方案, 这也是我们研发的重点之一。

Q7: 公司是否有产品用在机器人上? 主要原材料是什么?

A7: 公司有参与关于机器人项目的研发课题, 参加的北京市科技计划项目高精密谐波减速器设计与制造关键技术研究项目, 主要应用于小型机器人。该产品的主要原材料为铁基粉末, 采用粉末冶金工艺制作。

Q8: 公司机器人研发项目是否量产?

A8: 公司前期以研发为主, 现有上市公司与公司联系合作

开发相关零件，双方正处于洽谈阶段。

Q9：公司在手订单如何？

A9：公司的客户基本上都是比较稳定的长期客户，大多会定期下单，每年总量在三万吨左右。公司对明年的订单有一个比较好的预期。一是因为国内家电以旧换新政策、新能源车销量的增长以及高铁的快速发展，会为公司铜基板块带来好的收益；二是消费电子现在在回暖，对公司锡基板块会有带动作用；三是3D打印粉体板块，明年扩产应该会有一个比较大的增长。另外公司在泰国的生产基地今年六月已经正式投产，明年预计会有新的增量出来。

Q10：明年泰国大概会有怎样的盈利？

A10：公司对泰国基地明年的销量有一个比较好的预期。因为泰国公司自投产以来一直在做客户的到场验证，接待了很多轮国外客户的验证，效果都非常好。国外的市场本身在慢慢复苏，而一些竞争对手可能出于自身原因会发生一些变化，泰国公司如承接了这些公司的订单，会有一个较好的预期。

Q11：对于芯片半导体这块的贸易限制，公司锡基板块是否有预期？

A11：贸易限制对锡基微电子互连材料应该会有一个带动作用。半导体板块整合主打的应该就是国产替代，而国内用的部分锡粉目前是进口的，如果重新整合的话，国产锡粉替代会是一个非常大的趋势，对公司来说是一个很好的机会。

Q12：公司的锡膏主要应用于哪些领域？

	A12：公司的锡膏主要应用于光伏、LED、半导体等封装、组装应用行业。光伏方面主要应用于BC 电池技术。
关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明	不涉及
附件清单（如有）	
日期	2024 年 12 月 9 日